



# COMPEQ

*One-Stop PCB Service Provider*

# 免責聲明

- 除歷史事件之陳述外，本文件均為前瞻性敘述。該前瞻性敘述包括已知及未知風險、不確定性及其他可能導致華通電腦股份有限公司之實際表現、財務狀況或營運結果與該前瞻性敘述所包含者產生重大差別之因素。
- 本免責聲明中之財務預測及前瞻性敘述為目前華通電腦股份有限公司截至本文件之日之信念所編製。華通電腦股份有限公司不負責更新這些預測及前瞻性敘述以反映此日期後所發生之事件或情況。
- 歷史事件的陳述可能包括未經會計師審閱之資訊，其可能有某些不足或缺陷而無法忠實呈現目前華通電腦股份有限公司之財務狀況或營運結果。

# 華通專注於提供一站式服務，滿足客戶各項產品需求

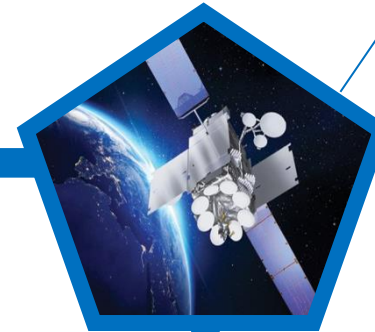
## 軟性電路板

- 電池管理模組
- 顯示器模組
- 攝像模組
- 穿戴裝置
- 周邊電子配件



## 硬性電路板

- 衛星通訊
- 資料處理中心
- 光通訊模組
- 汽車電子
- 智慧手機
- 筆電、平板
- 穿戴式裝置



# COMPEQ

One-Stop  
PCB Service Provider



## 表面黏著技術

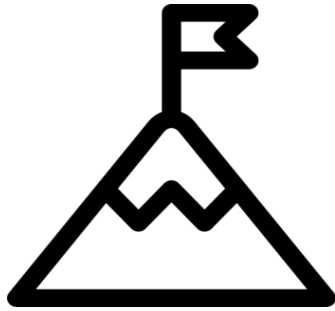
- 電池管理模組
- 汽車電子
- 醫療電子
- 周邊電子配件



## 軟硬結合電路板

- 電池管理模組
- 顯示器模組
- 攝像模組
- 穿戴裝置

# 華通為全球技術領先的 PCB 供應商



全球PCB供應商 **No. 8**



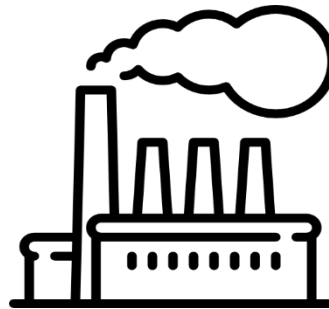
2025年營收  
新台幣 **760 億**



2014-2025 營收  
年複合成長率 **7.3%**



**20,000+** 員工人數



**8**座高科技且具成本競爭力的  
工廠設置於**台灣、大陸和泰國**

**Compeq Thailand**

Location: AIES Samut  
Prakan (30KM away  
from BKK airport)

Land area: 180K SQM  
Investment: 300 MUSD  
Mass production: Q1'25  
Capacity: 400KSF/M

# 華通全球廠區及據點分布

● Facilities  
 ■ Regional Office



重慶II廠  
 Y2021  
 900人  
 92K M<sup>2</sup>



泰國廠  
 Y2024  
 1,500人  
 66K M<sup>2</sup>



重慶I廠  
 Y2014  
 2,600人  
 56K M<sup>2</sup>



蘇州  
 Y2004  
 700人  
 42K M<sup>2</sup>



惠州 SMT  
 Y2012  
 3,500人  
 60K M<sup>2</sup>



惠州軟板  
 Y2004  
 4,700人  
 150K M<sup>2</sup>



惠州  
 Y1996  
 3,300人  
 151K M<sup>2</sup>



大園  
 Y1998  
 1,200人  
 42K M<sup>2</sup>



蘆竹  
 Y1973  
 3,300人  
 90K M<sup>2</sup>

# 華通競爭優勢

## 品質

在優異的品質管制系統下，提供高品質，高一致性，高信賴度、低缺點率的產品。

## 技術

領先導入類載板製程，提供20/20  $\mu\text{m}$ 細線路任意層薄板到52層6mm高信賴度厚板，以及軟板和軟硬結合板。

## ESG

符合法令規範，重視環境保護，注重勞工權益，公司治理。

## 服務

提供硬板、軟板、軟硬結合板，和打件的一站式電路板服務，並且和客戶共同開發新產品，參與早期設計開發階段，提供到製造、打件、出貨的完整服務。

## 長久關係

穩定經營與成長，擅於研發新技術，掌握客戶需求，提前做好準備，成為客戶共同發展的合作夥伴。

# 華通技術路線圖：高多層板

Items	Current	2027	2028
Min. Core Thickness	50 $\mu$ m	50 $\mu$ m	50 $\mu$ m
Buried Capacitance	25 $\mu$ m	12.5 $\mu$ m	12.5 $\mu$ m
Min. Outer layer Line Width / Space	75 / 75 $\mu$ m	75 / 75 $\mu$ m	62.5 / 62.5 $\mu$ m
Min. Inner layer Line Width / Space	50 / 50 $\mu$ m	50 / 50 $\mu$ m	50 / 50 $\mu$ m
Min. Drill Size for Thru-Hole	150 $\mu$ m	150 $\mu$ m	150 $\mu$ m
Min. PTH Drill Pad Size	350 $\mu$ m	300 $\mu$ m	300 $\mu$ m
Max. Board Thickness	6 mm	7 mm	8 mm
Max. Layer Count	52	56	60
Max. Plating Aspect Ratio	30 : 1	33 : 1	33 : 1
Back Drill Size	Drill + 150 $\mu$ m	Drill + 100 $\mu$ m	Drill + 75 $\mu$ m
Back Drill Stub Length	100 $\pm$ 50 $\mu$ m	75 $\pm$ 50 $\mu$ m	< 100 $\mu$ m
Material Trend	Low CTE; Low Dk/Df; Hybrid; Capacitance		

# 華通技術路線圖：HDI + HLC

Items	Current	2027	2028
Stack up	8-N-8	10-N-10	11-N-11
Max. Layer Count	48	48	56
Max. Micro-Via size	125 $\mu\text{m}$	150 $\mu\text{m}$	150 $\mu\text{m}$
Max. Skip Via size	15 mil	15 mil	16 mil
Max. Skip Via Aspect Ratio	1.0	1.0	1.0
Micro-Via to Pad Alignment	Drill + 150 $\mu\text{m}$	Drill + 125 $\mu\text{m}$	Drill + 100 $\mu\text{m}$
Line Width/Spacing (Build up)	30 / 40 $\mu\text{m}$	30 / 40 $\mu\text{m}$	30 / 40 $\mu\text{m}$
Max. Board Thickness	5 mm	5 mm	6 mm
Max. Plating Aspect Ratio	30 : 1	33 : 1	33 : 1

# Operation Revenue

	Mobile Phone	PC	Data Center / Networking	RF+FPC	SMT	Aerospace	Consumer & Others
2025 Q1	19%	15%	3%	22%	16%	23%	3%
2025 Q2	16%	16%	4%	25%	14%	22%	4%
2025 Q3	18%	13%	5%	28%	16%	17%	4%
2025 Q4	22%	10%	6%	26%	15%	17%	4%

	Mobile Phone	PC	Data Center / Networking	RF+FPC	SMT	Aerospace	Consumer & Others
2021	26%	23%	2%	21%	21%	3%	4%
2022	20%	26%	1%	23%	20%	7%	3%
2023	21%	20%	2%	23%	21%	9%	4%
2024	19%	15%	2%	25%	17%	18%	4%
2025	19%	13%	4%	26%	15%	20%	4%

<b>2025 vs. 2024 Rev. Growth</b>	<b>4%</b>	<b>-6%</b>	<b>95%</b>	<b>8%</b>	<b>-9%</b>	<b>13%</b>	<b>3%</b>
----------------------------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

# PCB 市場主要供應商 / 華通排名

Rank	Country	Supplier	2025 Revenue (M USD)
1	TWN 	Zhen Ding	\$5,869
2	TWN 	Unimicron	\$4,225
3	CHN 	Dongshan Precision	\$3,605
4	CHN 	Shennan	\$3,255
5	USA 	TTM	\$2,906
6	CHN 	WUS Group	\$2,760
7	CHN 	Victory Giant	\$2,688
<b>8</b>	<b>TWN</b> 	<b>Compeq</b>	<b>\$2,446</b>
9	TWN 	Tripod	\$2,361
10	JPN 	Mektec	\$2,273
11	CHN 	Kinwong	\$2,100
12	AUT 	AT&S	\$1,933
13	TWN 	Gold Circuit	\$1,928
14	TWN 	Hannstar	\$1,848
15	CHN 	Kingboard Group	\$1,732

Source: Prismark, 2026

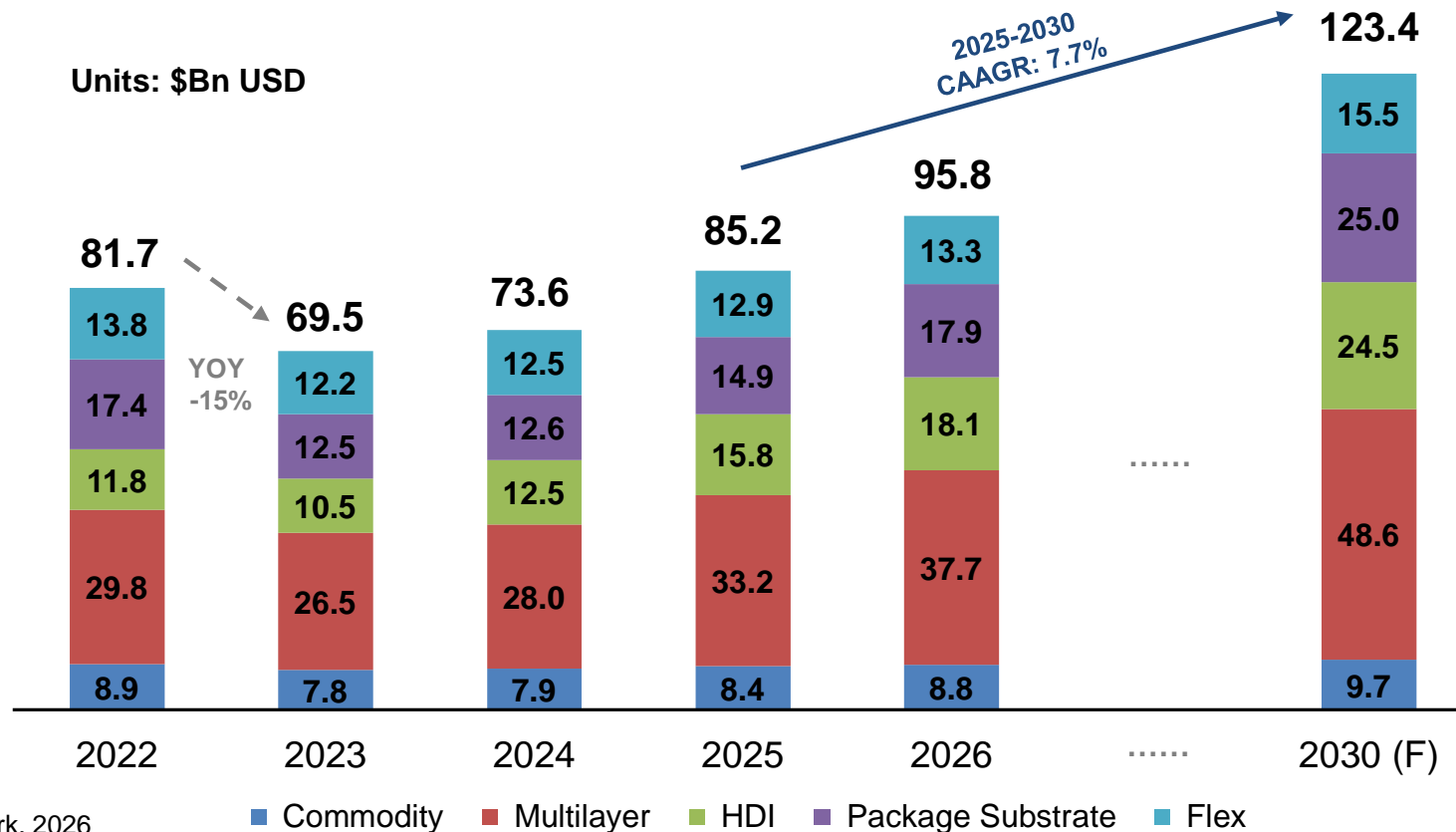
# HDI PCB 市場主要供應商 / 華通排名

Rank	Country	Supplier	2025 Revenue (M USD)
1	TWN 	Compeq	\$1,381
2	CHN 	WUS Group	\$1,179
3	TWN 	Unimicron	\$1,144
4	CHN 	Victory Giant	\$1,117
5	TWN 	Zhen Ding	\$967
6	AUT 	AT&S	\$956
7	USA 	TTM	\$907
8	TWN 	Tripod	\$834
9	JPN 	Meiko	\$697
10	CHN 	AKM Meadville	\$628

Source: Prismark, 2026

# PCB 產業趨勢

研究機構Prismark指出，整體PCB市場因AI科技的應用、高速運算/傳輸、衛星通訊、車用電子等產品需求成長，2025年PCB產值成長幅度約15.8%。2026年AI伺服器、交換器和其他網路產品的強勁需求持續帶動下，預期將成長12.5%。儘管長期發展充滿不確定性，仍預期電子產業將持續成長，預估PCB產值 2025-2030年複合成長率7.7%，達到1,234億美元。



Source: Prismark, 2026



**COMPEQ**

*Thank You For Your Attention*